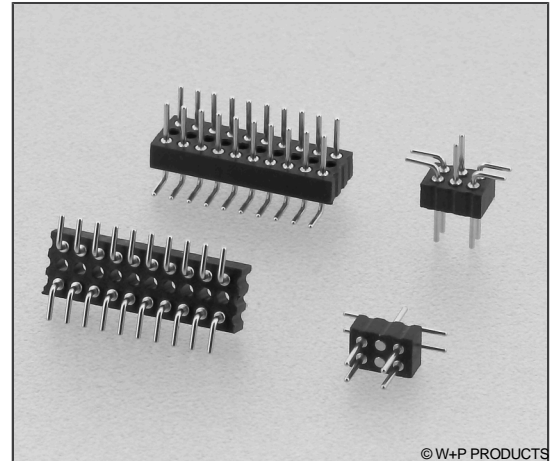


## SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, stehend, 2-reihig SMT Precision Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Vertical, Double Row

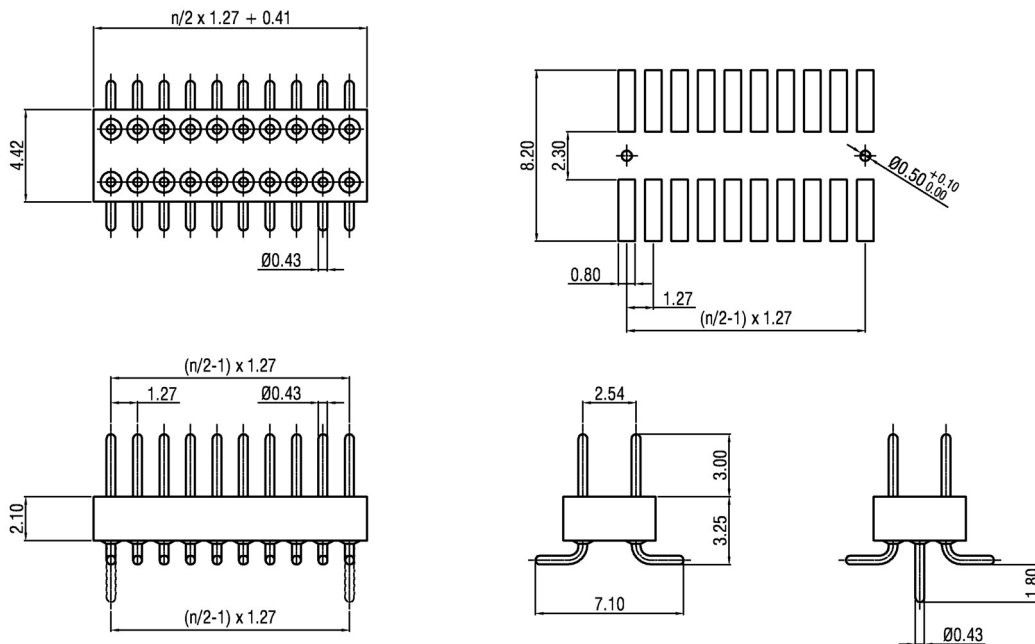
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundkontakt Ø0,43mm, Kupferlegierung <i>Ø0.43mm round contact, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>&lt; 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS <i>1 kV RMS</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A <i>1 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C <i>-55 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**1552**



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Plating*</b>	<b>Locating Pegs*</b>	<b>Packaging*</b>
<b>7062</b>	<b>040</b> 004-100 Zweireihig Double row	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 10 0,25µm Gold (Option) 0.25µm gold plated (Option)	<b>00</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	<b>ST</b> ST TR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**TR (Option)** Tape & Reel ohne P&P-Pads / Tape & Reel w/o P&P-Pads

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

